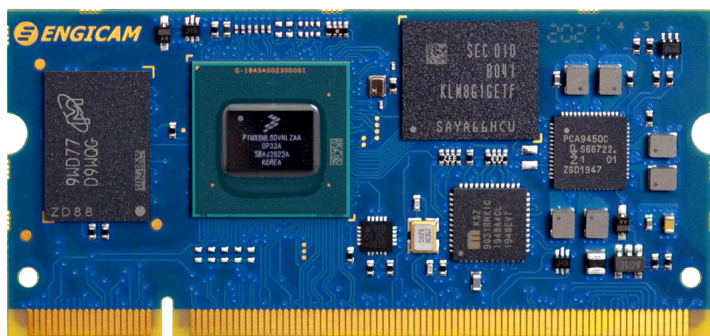


i.Core MX8M Plus

DIMM 2.0

Engicam presenta il nuovo modulo i.CoreMX8M Plus, equipaggiato dai core Cortex-A53 e Cortex-M7, nato per l'apprendimento automatico, connettività IoT, multimedia e applicazioni HMI per interfacce uomo-macchina.

Sviluppato sul versatile formato EDIMM 2.0.



IN EVIDENZA:

- Standard Edimm 2.0
- Quad Arm® Cortex®-A53 @ fino a 1.8GHz e Cortex®-M7 CPU @ 800 MHz con NPU (Neural Processing Unit)
- Adatto per HMI e applicazioni video ad alte prestazioni



APPLICAZIONI



Intelligenza Artificiale



Industriale



Automotive



Trasporti



Robotica



Biomedicale/
Dispositivi medici



Segnaletica digitale
Infotainment



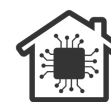
Aeronautica



Sorveglianza


















Gaming



Domotica

CARATTERISTICHE

 CPU	NXP® i.MX 8M Plus	 Memoria	Fino a 32GB eMMC
 Core	Quad Arm® Cortex®-A53 @ fino a 1.6GHz, processore con Neural Processing Unit (NPU) operativo fino a 2.3 TOPS + Cortex®-M7 CPU @ 800 MHz.	 Networking	Interfaccia 1 x Gb Ethernet
 Memoria	fino a 4GB LPDDR4	 USB	1 x USB OTG 3.0 1 x USB HOST 3.0
 Grafica	GC7000UL (2 shaders), OpenGL ES 2.0/3.0/3.1, Vulkan, OpenCL 1.2; GC520 (2D)	 Audio	Interfaccia I2S
 Interfacce Video	LVDS, 18/24bit fino a Full HD Opzione MIPI-DSI - 4 lanes HDMI fino a Full HD 2x MIPI-CSI - 4 lanes	 Periferiche	UART, I2C, PCIe 3.0, SPI, JTAG, CAN, SDIO, SPI, GPIO
 Capacità Videoprocessore	1080p60 HEVC (h.265, h.264, VP9, VP8) dec; 1080p60 HEVC (h.265, h.264) enc	 Alimentazione	+ 5V DC
		 Sistema Operativo	Linux - Yocto, Android
		 Temperatura Operativa*	Industriale (da -40°C a 105°C)
		 Dimensioni	32.1 x 67.6 mm

** Validi per tutti i componenti ad eccezione della CPU. Il cliente deve considerare la temperatura di giunzione della CPU. La temperatura dipenderà ampiamente dall'applicazione. Potrebbero essere necessarie specifiche soluzioni di raffreddamento per il sistema finale.

